

Další možný způsob rychlého pájení SMD součástek, který je vhodný pro amatérské bastlíře. Metoda pájení přetavením je jedna z nejpoužívanějších v průmyslovém pájení SMD součástek, jelikož vyniká hlavně svojí jednoduchostí a rychlostí. Na vyleptanou a pokovenou desku plošných spojů se na pájecí plošky nanese tavidlo s pájecí pastou, následně se osadí součástky a celý plošný spoj vjede do přetavovací pece.

V první fázi dojde k postupnému ohřátí plošného spoje, aby se předešlo teplotnímu šoku a také dochází k odpaření rozpouštědel z tavidla. Teplota by měla narůstat přibližně o 2-3°C/s. Při dostatečné teplotě dojde k aktivaci tavidla, které rozruší oxidy na pájecích plochách a připraví je k zapájení. Ve druhé fázi je teplota zvýšena na hodnotu o přibližně 40°C nad teplotu tání pájecí pasty a dochází k zapájení součástek. Dobrou zprávou je, že díky povrchovému napětí se při zapájení součástky vystředí a nevadí tedy ne úplně přesné osazení součástek (neplatí u bezolovnatých pájek!). Třetí fáze slouží k postupnému vychladnutí součástek a pájení je hotovo.

Přetavovací křivka



Průmyslová přetavovací pec

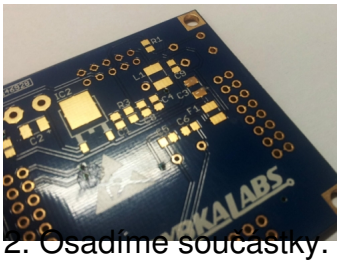
A jak si tedy zrealizovat pájení přetavením v amatérských podmínkách?

Nejprve je nutné pořídit si přetavovací pec, v našem případě starý gril (za který děkujeme členovi našeho radioklubu, Jonáši Pačískovi).

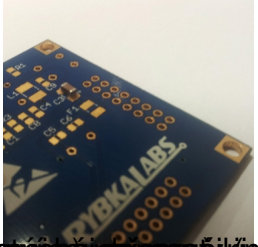

ETAGRIL

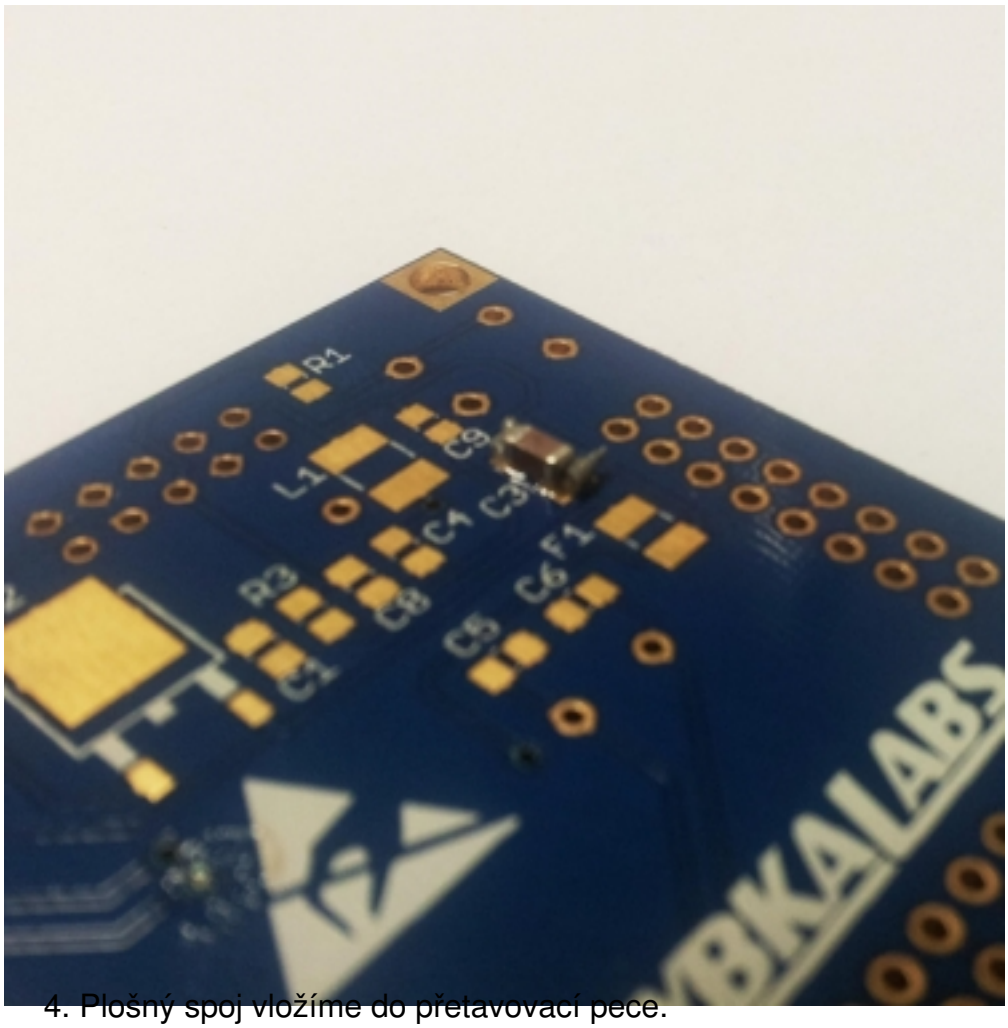






2. Osadíme součástky.

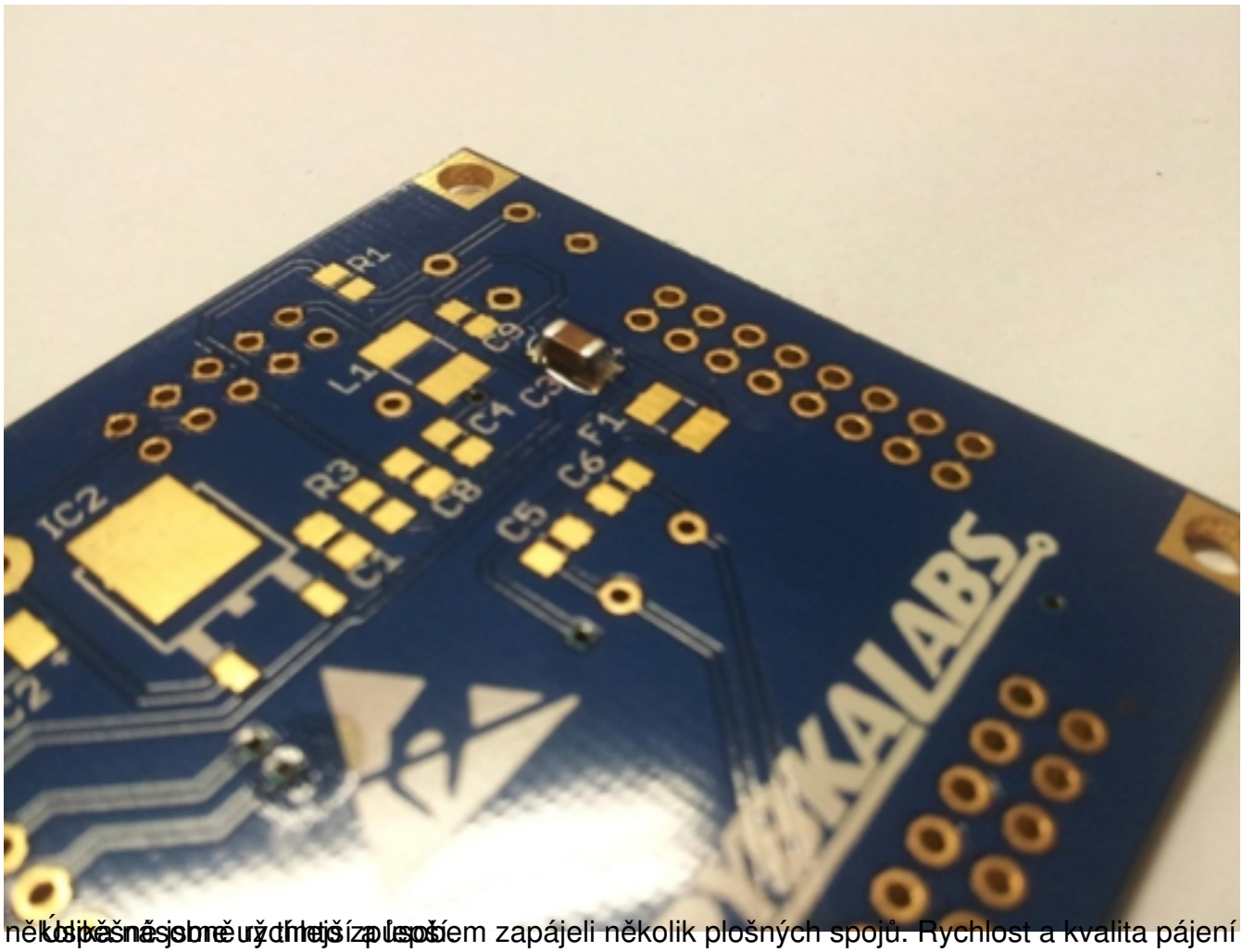




4. Plošný spoj vložíme do přetavovací pece.

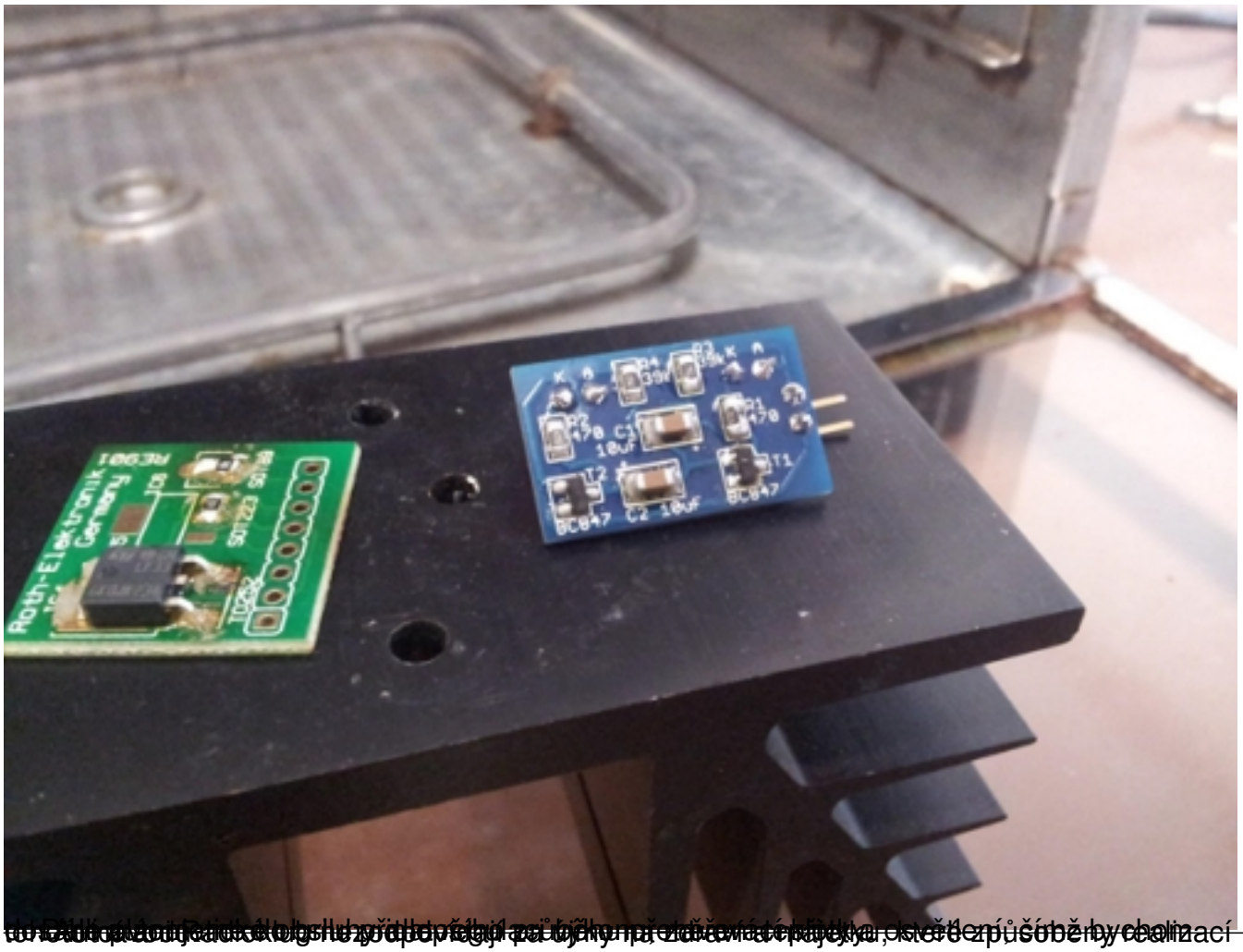






Ukázka našeho nejmenšího pájecího zařízení. Jedním takovým zapájeli několik plošných spojů. Rychlost a kvalita pájení




Roth-Elektronik
Germany
RE981
BC847
BC847
C1
10µF
C2 10µF
R1
470
R2
470
R3
33k
R4
33k